



RE936-04

- Multiadaptador para TSOP56 y HTSOP56
- Fibra de vidrio epoxídica FR4 1,50 mm
- Por dos lados 35 µm de Cu
- Agujeros con contactos metalizados (PTH)
- Superficie terminal química de Ni/Au
- Máscara de inhibidora de la soldadura
- Placa de circuito impreso de adaptación para TSOP56 y HTSOP56 con 0,65 mm Pitch
- Espacio entre orificios en una línea 2,54 mm
- Taladros de Ø 1,10 mm con nodos de soldadura Ø 2,20 mm
- Dos zonas de experimentación con 8 x 8 nodos de soldadura cuadrados de 2,20 x 2,20 mm
- Campo de apantallado y superficie de refrigeración
- Tamaño 73,66 x 43,18 mm